

# 龙华区线路板贴片加工

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：15

相信大家平时在BGA焊盘设计及钢网开口设计中会遇到很多问题，深圳杰森泰就来帮大家盘点一下这些常见问题及解决方案，一起来看看吧BGA焊盘的常见设计问题包含以下几点

- 1 BGA底部过孔未进行处理
- 2 BGA焊盘存在过孔，焊球在焊接过程中随焊料流失
- 3 PCB制作未实施阻焊工艺，导致焊料及焊球通过与焊盘相邻的过孔流失，造成焊球缺失
- 4 BGA阻焊膜设计不良
- 5 PCB焊盘上置导通孔将导致焊料流失；高密度组装中必须采取微孔、盲孔或塞孔工艺才能够避免焊料流失
- 6 BGA底部有过孔，过波峰焊后，过孔上的焊料影响BGA焊接的可靠性，造成元器件短路等缺陷
- 7 BGA焊盘设计
- 8 BGA焊盘引出线不超过焊盘直径的50%，电源焊盘的引出线不小于0.1mm
- 9 然后方可加粗。为了防止焊盘变形，阻焊开窗不大于0.05mm
- 10 焊盘尺寸不规范，过大或过小
- 11 BGA焊盘大小不一，焊点为大小不一的不规则图形
- 12 BGA外框线与元器件本体边缘距离过小。元器件所有部位均应位于标线范围之内，框线与元器件封装体边缘间距应大于元器件焊端尺寸的1/2以上。

杰森泰搞SMT贴片的优势是速度快，沟通快，质量有保证，价格还便宜。龙华区线路板贴片加工

SMT贴片分为有铅和无铅两个概念。无铅工艺：无铅化电子组装的一个基本概念就是在软钎焊过程中，无论手工烙铁焊、浸焊、波峰焊还是回流焊，所采用的焊料都是无铅焊料(pb-feersoder)

无铅焊料并不意味着焊料中100%的不含铅。在有铅焊料中，铅是作为一种基本元素而存在的。在无铅焊料中，基本元素不含有铅。有铅工艺：传统的印刷电板组装的软钎焊工艺中，一般采用锡铅(sn-pb)焊料，其中铅是作为焊料合金的一种基本元素而存在并发挥作用。番禺区什么叫贴片加工收费BGA空焊的原因主要是温度不够或是PCB变型

SMT贴片加工中要注意看一下。

bga植球的操作方法/步骤:(“锡膏”+“锡球”)

- 1、先准备好bga植球的工具，植球座要清理干净，以免锡球滚动不顺;
- 2、把预先整理好的芯片在植球座上做好定位;
- 3、然后把锡膏均匀上到刮片上;
- 4、往定位基座上套上锡膏印刷框，印刷锡膏，要尽量控制好手刮有时的角度、力度及拉动的速度，完成后轻轻脱开锡膏框;
- 5、确认BGA上的每个焊盘都均匀印有锡膏后，再把锡球框套上定位，然后放入锡球，摇动植球座，让锡球滚动入网孔，确认每个网孔都有一个锡球后就可收好锡球并脱板;
- 6、把刚植好球的BGA从基座上取出待烤，比较好能用回流焊，但如果量小用热风枪也行。这样就完成植球了。

关于电阻、电容这类SMD小零件有空焊的问题,它的生成原因就跟立碑的原因是一样的，说白了就是零件两端的锡膏融化时间不一致，终造成受力不均，以致一端翘起的结果。通常PCB进入回流炉子并开始加热时，越是表面的铜箔，其受热的程度会越快，会比较快到达回焊炉内的环境温度，而越内层的大片铜箔的受热则会较慢，会比较慢到达回焊炉内的环境温度，当零件一端的锡

膏比另一端较早融化时，就会以锡膏先融化的这端为支点举起零件，造成零件的另一端空焊，随着锡膏融化的时间差越大，零件被举起的角度就会越大，形成完全立碑的结果。我认识搞SMT贴片加工的杰森泰，开始时只有一个人，那时就是用吹风烙铁手工帮我焊板，我们认识了20年了。

PCB板子做好后，需要贴装元器件，现在元器件的贴装都是通过机器来完成的。SMT中会用到mark点。一、什么是mark点Mark点也叫基准点，为贴装工艺中的所有元器件的贴装提供基准点。因此Mark点对SMT生产至关重要。二、MARK点作用及类别MARK点分类：单板MARK贴装单片PCB时需要用到，在PCB板上；拼板MARK贴装拼板PCB时需要用到，一般在工艺边上；局部MARK用以提高贴装某些元器件的精度，比如QFP、BGA等封装mark点是由标记点/特征点和空旷区组成的。深圳SMT贴片加工厂哪家好？江岸区LED贴片加工哪家好

搞SMT贴片的杰森泰老板来自湖北长阳的一个小山区，从小都缺衣少食，不过我认为山区风景好，空气好。龙华区线路板贴片加工

可以看到焊盘上有明显的红墨水痕迹，说明在焊接过程中锡球与焊盘并未融合在一起，中间留有缝隙，被红墨水浸入并染色这种情况说明在SMT贴片过程中存在问题导致BGA焊接不良，比如PCB或锡球氧化、焊盘锡膏没有涂沫到位、波峰焊炉温或区线有问题等，这种情况一般属于生产端造成的。2、PCB或BGA的焊盘上没有红墨水痕迹，但在焊盘周边可以看到明显的红墨水浸入到焊盘下面并染色，这种情况说明PCB或BGA芯片的质量有问题。一般是在原料生产过程中出现了问题，导致焊盘脱裂产生缝隙，是属于PCB板材或是BGA芯片供应商的问题。3、PCB或BGA的锡球焊盘位置有部分被红墨水浸入并染色，这说明测试的主板本身在生产或元件上并无问题，但在使用过程中受到外力影响导致锡球不均匀地开裂。一般这种情况是由于主板使用过程中某个方向或位受力过大，由应力导致的锡球断开产生了缝隙，这个就要考虑客户使用问题或是主板的设计问题了。看，小小的红墨水居然有这么大的用处，是不是感觉到大开眼界？其实这是用了液体可以自由入任何可以进入的空间这个很简单的原理。不过往往简单的方法就是更好的方法，通过小小的红墨水就可以对复杂的BGA空焊问题做一个有效的判断，你了解了吗？龙华区线路板贴片加工

深圳市杰森泰科技有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在广东省等地区的电工电气中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，\*\*协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来深圳市杰森泰科技供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！